

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年3月2日(02.03.2023)



(10) 国際公開番号

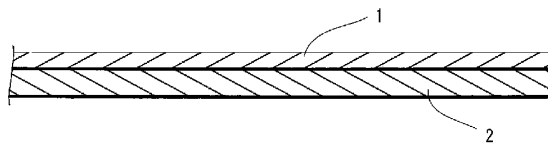
WO 2023/026584 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/29 (2006.01) C08L 71/10 (2006.01)
H01L 23/31 (2006.01) H01L 21/52 (2006.01)
C09J 163/02 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01) C09J 7/30 (2018.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/017919
- (22) 国際出願日: 2022年4月15日(15.04.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-135624 2021年8月23日(23.08.2021) JP
- (71) 出願人: 古河電気工業株式会社(FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 坂井 小雪(SAKAI, Koyuki); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 森田 稔(MORITA, Minoru); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人イイダアンドパートナーズ, 外(IIDA & PARTNERS et al.); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: FILM-LIKE ADHESIVE AGENT, AND ELECTRONIC COMPONENT USING SAME AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: フィルム状接着剤、これを用いた電子部品及びその製造方法

[図1]



(57) Abstract: A film-like adhesive agent comprising an epoxy resin (A), an epoxy resin curing agent (B), and a phenox resin (C), wherein the contained amount of the epoxy resin curing agent (B) in the film-like adhesive agent is 0.30-12.0 mass%, the light transmittance T1 of the film-like adhesive agent at a wavelength of 400 nm is 90% or less, the light transmittance T2, at a wavelength of 400 nm, of a cured object obtained through thermosetting of the film-like adhesive agent is 85% or more, and T1<T2 is satisfied.

(57) 要約: エポキシ樹脂 (A)、エポキシ樹脂硬化剤 (B)、及びフェノキシ樹脂 (C) を含有するフィルム状接着剤であって、前記フィルム状接着剤中、前記エポキシ樹脂硬化剤 (B) の含有量が 0.30~12.0 質量%であり、前記フィルム状接着剤の波長 400 nm の光透過率 T1 が 90% 以下、前記フィルム状接着剤を熱硬化してなる硬化物の波長 400 nm の光透過率 T2 が 85% 以上、かつ T1<T2 を満たす、フィルム状接着剤。

[続葉有]

WO 2023/026584 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）